

证券代码：688627

证券简称：精智达

深圳精智达技术股份有限公司

（深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园
D栋1楼东）



2026年度向特定对象发行A股股票论证 分析报告

二〇二六年二月

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达”或“公司”）是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》的规定，公司编制了2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告。

本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳精智达技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。

一、本次向特定对象发行股票的背景

（一）国家相关产业政策为半导体测试设备企业发展营造了良好的宏观环境

半导体产业是信息技术产业及现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是当前衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。半导体设备作为半导体产业发展的核心驱动力，近年来国家出台一系列鼓励扶持政策，为其高质量发展提供坚实支撑，具体如下：

序号	时间	发文部门	法律法规及政策	主要内容
1	2025年10月	中共中央	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	提出加强原始创新和关键核心技术攻关，完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
2	2025年8月	工信部、市监总局	《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》	坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链……强化计算等领域芯片、零部件、整机系统等研发应用和配套适配。
3	2024年7月	中国共产党二十届三中全会	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进

序号	时间	发文部门	法律法规及政策	主要内容
				材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。
4	2023年2月	工信部等七部门	《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》	供给能力提升重点方向：关于电子行业方面，突破电性能测试系统、高精度探针台等。
5	2023年12月	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	将球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SIP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）、2.5D、3D等一种或多种技术集成的先进封装与测试，集成电路装备及关键零部件制造列为鼓励类产业。
6	2021年12月	财政部等五部门	《国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2021年修订）》	集成电路自动化测试及分选设备属于国家支持发展的重大技术装备和产品。

公司作为专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业，以实现关键设备自主可控为核心目标，着力构建系统化全站点服务能力。国家陆续出台的相关产业政策，充分凸显了公司所属行业在国民经济中的重要地位，各项政策的密集发布与落地实施，为公司业务发展营造良好经营环境，并提供坚实有力的政策支持。

（二）下游新兴需求的不断涌现及国产替代进程加快为半导体测试设备企业发展提供了巨大的市场空间

下游前沿技术迭代与终端产品创新形成的新需求，正从多维度推动半导体测试检测设备的技术升级。人工智能作为推动科技进步与产业变革的核心力量，其生态构建日趋完善，持续推升算力需求。与此同时，HPC、XR等应用对芯片算力、存储带宽及人机交互、显示精度要求不断提升。

随着摩尔定律逐渐逼近极限，2.5D/3D封装、Chiplet等先进封装技术成为关键路径，芯片结构从平面走向立体，其复杂的互连结构与集成形态对测试设备的信号精度、多通道协同能力及系统兼容性提出更高要求。HBM凭借高带宽优势已成为高性能计算和人工智能的重要解决方案，驱动测试设备向高精度、高并行测试能力方向迭代。设备架构复杂化及人工智能对高性能的需求共同推动半导体

测试设备市场增长。根据 SEMI 预测，2025 年全球半导体测试设备销售额将增长 48.10% 至 112 亿美元。同时，XR 及智能眼镜的快速发展亦驱动 Micro OLED/LED 等微显示技术加速产业化。根据 IDC 数据显示，2024-2029 年全球 AR/VR 市场规模将增至 397 亿美元，复合增长率达 21.1%，其中，中国市场表现尤为突出，以 41.4% 的复合增长率成为全球最重要的增长极。这一趋势不仅推动微显示技术快速迭代，更将为国产检测设备厂商创造增量空间。

随着全球贸易摩擦加剧，我国半导体产业面临着供应链安全和技术突破的严峻挑战，高端半导体测试检测设备进口替代需求日益迫切。在此背景下，我国高端半导体测试检测设备国产化进程有望进一步加速，本土厂商必将充分受益。

（三）提升高端半导体存储测试设备产业化能力、巩固并进一步提升公司在半导体测试设备领域市场地位和竞争力

全球及中国半导体测试设备市场正进入由 AI 算力、先进封装等驱动的强劲扩张期。根据 SEMI 预测，2025 年全球半导体测试设备销售额将增长 48.10% 至 112 亿美元。根据 Trend Force 数据，2025 年国内 DRAM 晶圆投入量预计达 273 万片，同比增长 68.5%，国内主流存储厂商正加速扩产与技术升级。在此背景下，国内对高端半导体存储测试设备的配套需求必将呈现同步快速增长。

受 AI 时代下 HBM、算力芯片等高端测试需求爆发式增长的影响，高端半导体存储测试设备市场面临持续供应缺口。与此同时，随着中国加快构建自主供应链建设，国内对本土高端半导体存储测试设备需求将进一步增加。

公司是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，已于部分产线成功取代国外供应商成为相关产品主要供应商，实现重要生产环节自主可控。下游客户旺盛的市场需求给公司提供良好市场机遇期。然而，公司高端半导体存储测试设备产业化能力目前难以满足下游客户的设备需求，提升高端半导体存储测试设备产业化能力有其迫切性，有利于巩固并进一步提升公司在半导体测试设备领域市场地位和竞争力。

（四）积极践行国家半导体产业的关键核心技术攻关和科技突破的发展战略，以技术创新引领新质生产力发展

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确将“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”作为核心任务，强调在集成电路等重点领域推动关键核心技术取得决定性突破。推动科技创新，强化企业科技创新主体地位。

公司深刻把握十五五规划的战略导向，立足行业发展前沿，以成为半导体测试设备领域技术引领者为目标，持续深化科技创新。本次发行是公司响应国家战略的关键举措，旨在突破高端半导体测试设备关键核心技术自主可控难题，持续迭代半导体存储测试、AI 芯片测试等高端半导体测试设备，以进一步夯实公司自身技术壁垒，提升创新能力，更将以自主创新技术带动产业链上下游协同升级，引领半导体测试设备领域新质生产力发展，为国家集成电路产业高质量发展提供核心装备支撑。

二、本次发行证券及其品种选择的必要性

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）本次发行证券的必要性

1、把握行业发展机遇，提高公司高端半导体测试设备产业化能力，深化“设备平台+解决方案”的综合能力

公司是一家专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业，以实现关键设备自主可控为核心目标，着力构建系统化全站点服务能力。依托多年在半导体存储测试领域的深耕积累和自主创新，产品线已覆盖半导体存储器测试领域的关键测试设备和治具，主要产品包括晶圆测试设备、老化测试及修复设备、高速 FT 测试设备、MEMS 探针卡、老化治具板、FT 测试治具等，是国内少数实现半导体存储器测试设备全覆盖的厂商，已于部分产线成功取代国外供应商成为相关产品主要供应商，实现重要生产环节自主可控。

近年来，受益于下游市场需求旺盛、公司技术迭代与应用场景的不断拓展，

公司半导体测试设备业务呈现快速增长趋势。然而，当前半导体产业正经历深刻变革，人工智能、高带宽存储芯片等新兴领域推动 2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装技术的快速发展，芯片内部结构日趋复杂，性能水平持续提升，相应对半导体测试设备的技术水平提出更高要求。目前，作为 AI 和 HPC 芯片中关键部分的 HBM 的测试逻辑已发生根本性变化。由于 HBM 堆叠层数高且与 GPU 深度绑定，测试模式已从传统的“抽样测试”转向“全深度测试”，这导致测试时间大幅延长，从而推高了测试设备的需求量。HBM 的复杂性和高价值属性使得存储测试设备需求呈现出技术升级和测试密度提升所带来的结构性增长机会。

为了更好地满足客户对高端半导体测试设备日益增长的市场需求，公司需要持续提升高端半导体测试设备的产业化能力，进一步提升“设备平台+解决方案”的综合服务能力，巩固并提升公司在半导体测试设备领域的竞争力。本次募集资金投资项目的实施有助于公司持续提高半导体测试设备升级迭代及产业化能力，抓住行业高速发展机遇。

2、增强公司研发实力，持续提升公司产品和技术创新能力

公司所处行业为知识和技术密集型行业，产品研发涉及电子电路设计、精密光学、精密机械设计与自动化控制，以及软件算法等多学科、多领域知识的综合运用，具有较高的技术和客户验证壁垒。国外龙头设备厂商通过长期大规模的研发投入，以此保持产品技术优势并巩固行业领先地位。

公司聚焦于半导体测试检测设备及系统解决方案领域，具有较强的竞争优势，但受限于技术积累、研发资金实力等因素，在产品及研发布局方面与国外龙头厂商尚存在一定差距，需要持续的研发投入，以提升公司整体研发实力及技术优势。随着人工智能与实体经济加速融合、微显示技术的产业化加速以及终端应用场景多元化趋势，下游客户对设备供应商的要求日趋提高，不仅要提供高精度检测硬件，还需结合 AI 算法、数据分析构建定制化解决方案。为了持续满足下游客户的产品迭代需求，公司需要持续提升半导体测试检测方面的研发能力和技术竞争力。

本次募集资金投资项目的实施有助于公司紧跟行业发展前沿趋势和客户需求，布局半导体测试检测设备领域前沿技术，进一步增强公司研发实力，逐步缩

小与国外龙头厂商的差距，更好地满足下游客户在新兴领域对更高测试性能指标的迫切需求，为实现我国半导体测试检测设备自主可控贡献力量。

3、增强公司资金实力，提升运营能力，推动公司持续高质量健康发展

公司所处行业为资金密集型行业，技术研发、生产运营及相关服务都需要大量的持续资金投入。目前，公司正处于业务发展重要机遇期，在巩固既有业务优势的同时，持续聚焦新技术突破、新产品落地及新市场拓展，核心业务板块保持稳健增长。公司经营规模的持续扩大，带动原材料采购、薪酬支出、市场开拓等方面对营运资金的需求不断增加，加之存货、应收账款等经营性项目的资金占用规模相应增长，为了更好地开拓市场及支撑公司持续增长的采购需求，公司需要补充并维持一定规模的营运资金以支撑业务快速扩张。

通过本次向特定对象发行，公司将充分利用资本市场优势，增强自身资金实力，部分募集资金拟用于补充流动资金，以满足公司日益增长的经营性现金流需要，提高公司抗风险能力，持续增强公司核心竞争力和盈利能力。

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性

（一）本次发行对象选择范围的适当性

本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

本次发行对象的选择范围符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行对象的选择范围适当。

(二) 本次发行对象数量的适当性

本次发行的发行对象数量不超过 35 名(含 35 名)，发行对象的数量符合《注册管理办法》等相关法律法规的规定，发行对象数量适当。

(三) 本次发行对象标准的适当性

本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行对象的标准适当。

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

(一) 本次发行的定价原则及依据

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证

监会作出予以注册决定后，由公司董事会及其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

（二）本次发行定价的方法和程序合理

本次发行的定价方法和程序均根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定，公司召开了董事会并将相关公告在交易所网站及中国证监会指定的信息披露媒体上进行披露，并将提交公司股东会审议。

本次发行定价的方法和程序符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，本次发行定价的方法和程序合理。

综上所述，本次发行定价的原则、依据、方法和程序均符合相关法律法规的要求，合规合理。

五、本次发行方式的可行性

（一）本次发行符合《公司法》《证券法》相关规定

1、本次发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，本次发行的股票种类与发行人已发行上市的股份相同，均为人民币普通股，每一股份具有同等权利，符合《公司法》第一百四十三条的规定。

2、本次发行股票的发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百四十八条的规定。

3、本次发行方案已经公司第四届董事会第九次会议通过，并拟提交股东会审议，符合《公司法》第一百五十一条的规定。

4、本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条的规定。

本次发行相关事项尚待取得上海证券交易所的审核同意以及中国证监会的注册，符合《证券法》第十二条之规定。

（二）本次发行方案符合《注册管理办法》的相关规定

1、本次证券发行符合《注册管理办法》第十一条的规定

发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形：

(1) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；

(2) 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

(3) 现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

(4) 上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

(5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

(6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2、公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的相关规定

本次向特定对象发行股票，募集资金使用符合以下规定：

(1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

(2) 除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

(3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

(4) 科创板上市公司发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。

(三) 公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享完善失信联合惩戒机制的意见》规定的需要惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业

经核查，公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享完善失信联合惩戒机制的意见》规定的需要惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业。

(四) 公司本次向特定对象发行股票符合《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）的相关规定

1、符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条的规定

公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

2、符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第二条的规定

公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

3、符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条的规定

(1) 本次公司拟发行的股份数量不超过发行前公司总股本的 30%。

(2) 公司已就本次发行相关事项履行了董事会决策程序，且董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过 18 个月。

4、符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条的规定

上市公司通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行

股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。

公司本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条的规定。

（五）本次发行程序合法合规

本次发行方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，且已在交易所网站及指定的信息披露媒体上进行披露，履行了必要的审议程序和信息披露程序。本次发行方案尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

综上，公司不存在不得发行证券的情形，本次发行符合相关法律法规的规定，发行方式亦符合相关法律法规的要求，审议程序及发行方式合法、合规、可行。

六、本次发行方案的公平性、合理性

本次发行方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。本次发行方案的实施将有利于公司持续稳定的发展，有利于增加全体股东的权益，符合全体股东的利益。

本次发行方案及相关文件在交易所网站及指定的信息披露媒体上进行披露，保证了全体股东的知情权。公司将召开审议本次发行方案的股东会，全体股东均可对公司本次发行方案进行公平的表决。股东会就本次发行相关事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况将单独计票，公司股东可通过现场或网络表决的方式行使股东权利。

综上所述，本次发行方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，发行方案符合全体股东利益；本次发行方案及相关文件已履行了相关披露程序，保障了股东的知情权；本次发行股票的方案将在股东会上接受参会股东的公平表决，具备公平性和合理性；本次发行不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益

的情形。

七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施

（一）本次发行对公司主要财务指标的影响

1、分析的主要假设和前提

为分析本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出如下假设：

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

（2）假设公司于 2026 年 11 月末完成本次发行。该时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

（3）假设本次募集资金总额为不超过人民币 295,900.00 万元，暂不考虑发行费用等影响。假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的 30%，即不超过 28,203,526 股（含本数）。在预测公司总股本时，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑股权激励、期权激励、转增、回购、股份支付及其他因素导致股本变化的原因。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准。

（4）根据公司披露的《2025 年度业绩快报》，公司 2025 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,140.88 万元（前述数据未经审计，最终结果以公司 2025 年年度报告为准）。假设 2026 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润按以下业绩增幅分别测算：（1）与 2025 年度经营情况持平；（2）较 2025 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长 15%；（3）较 2025 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长 30%三种情形，依此测算 2026 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。（该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要

财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测）。

（5）本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素、限制性股票归属、可转债转股等对公司财务状况（如财务费用、投资收益）、股本等的影响。

（6）本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

2、本次发行对公司每股收益的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益的影响，测算结果如下表所示：

项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日	2026 年度/ 2026 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	9,401.18	9,401.18	12,221.53
假设 1：2026 年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与 2025 年度持平			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	6,140.88	6,140.88	6,140.88
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.65	0.65	0.64
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.65	0.65	0.64
假设 2：2026 年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较 2025 年度增加 15%			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	6,140.88	7,062.01	7,062.01
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.65	0.75	0.73
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.65	0.75	0.73
假设 3：2026 年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较 2025 年度增加 30%			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	6,140.88	7,983.14	7,983.14

项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日	2026 年度/ 2026 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.65	0.85	0.83
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.65	0.85	0.83

注：基本每股收益、稀释每股收益等指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的公式计算得出。

（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果公司业绩暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成后公司的即期回报（每股收益等财务指标）将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况和趋势的判断，亦不构成公司盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（三）本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见本报告“二、（二）本次发行证券的必要性”。

（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目包括半导体存储测试设备研发及产业化智造项目、高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目及补充流动资金，上述募投项目紧密围绕公司主营业务展开，是公司现有业务的补充和升级，顺应行业市场发展方向，符合公司业务布局及未来发展战略。

其中，半导体存储测试设备研发及产业化智造项目将进一步提高公司高端半导体存储测试设备研发及产业化能力，增强公司产品技术能力，不断推动公司现有产品升级迭代，更好满足下游客户对半导体测试设备需求，支撑公司高质量可持续发展。

高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目将进一步提高公司技术创新能力，面向下游市场前沿技术需求，推进公司半导体测试检测设备新产品研发进程，巩固公司产品技术优势，持续提高公司的核心竞争力。

补充流动资金可在一定程度上解决公司未来经营性现金流需求，降低公司财务风险，为公司经营规模快速增长提供相应的资金保障。

2、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(1) 人员储备

公司注重人才队伍建设，持续引入高层次人才并强化自主培养体系，构筑了跨专业、多层次的人才梯队。公司通过持续完善薪酬体系和激励机制，引进优秀人才，充分激发员工积极性和创造力。截至 2025 年 6 月末，公司研发人员数量为 309 人，占公司总人数的比例为 48.51%，核心技术研发团队稳定，具有较强的技术人才优势。

(2) 技术储备

公司坚持以客户实际需求、技术发展趋势以及产业应用实践为研发导向，持续提升技术创新能力，通过对新技术的战略布局实现技术自主创新及自主可控。公司重点聚焦半导体设备领域，持续加大自主研发投入，形成了多项关键核心技术。公司注重知识产权保护，构建了完善的知识产权体系，截至 2025 年 6 月末，公司累计取得知识产权 466 项，其中发明专利 131 项。公司丰富的核心技术储备为本次募集资金投资项目的实施提供了坚实的技术基础。

(3) 市场储备

公司积极推进客户开发与维护，与国内头部半导体存储厂商及新型显示制造厂商建立了紧密稳定的业务合作关系。公司核心产品已应用于国内头部半导体厂

商生产线，在市场上具有较强的竞争力，助力客户在降低测试成本、逐步实现供应链国产替代的同时提升生产质量，获得了客户的广泛认可。

（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致股东即期回报有所下降，为了保护投资者利益，公司采取以下措施提升公司竞争力，以填补股东回报。

1、增强公司核心竞争力，扩大公司业务规模

公司将持续深耕半导体测试检测设备及系统解决方案领域，以实现关键设备自主可控为核心目标，着力构建系统化全站点服务能力。公司将把握半导体产业高速发展的市场机遇，扩大半导体测试设备产业化能力并持续加大研发投入，布局前沿技术，拓展公司产品矩阵与技术应用领域，不断增强核心竞争力，扩大公司业务规模。

2、加强募集资金管理，保证募集资金规范和有效使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等管理制度。这些制度对公司募集资金的存放、使用、管理以及相关信息的披露进行了规范，保证了公司募集资金的存放和使用的安全，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，切实保证募集资金的合理规范使用。

3、持续完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，确保股东能够充分行使股东权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、合理的各项决策；确保董事会审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障；确保独立董事能够独立履行职责，维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。

未来公司将进一步提高经营和管理水平，完善并强化经营决策程序，全面有效地提升公司经营效率，控制公司经营风险。

4、强化投资者回报机制，保障股东利益

为进一步完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，就利润分配政策事宜进行了详细规定，并制定了《深圳精智达技术股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

本次发行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，确保利润分配政策的连续性与稳定性，有效维护和增加对股东的回报水平，切实保障股东权益。

（六）相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺

1、公司的控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人张滨承诺如下：

“一、继续保证公司的独立性，不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益；

二、自本承诺函出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

三、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应补偿责任。”

2、公司董事、高级管理人员的承诺

公司的全体董事、高级管理人员承诺如下：

“（一）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。

（二）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他

方式损害公司利益。

(三) 对本人的职务消费行为进行约束。

(四) 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

(五) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(六) 如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

在承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

八、结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，将有利于进一步提高公司未来业绩，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2026年2月27日